

「産学連携支援センター埼玉」

令和元年度 第2回 産学連携技術シーズ発表会



テーマ

# 「精密加工技術」

2019年10月18日(金)

13:30~17:00(受付13:00~)

会場：新都心ビジネス交流プラザ 4階会議室  
(さいたま市中央区上落合2-3-2)

参加費：無料 定員：50名

「産学連携支援センター埼玉」は、ビジネス展開や課題解決に役立つ大学・研究機関・企業の様々な技術シーズを紹介し、「産・学」「産・産」の連携を促進します。今回は、「精密加工技術」を紹介。「レーザー加工」「切削加工」等、様々な加工技術を紹介します。

ポスターセッション・名刺交換会では、具体的な技術相談から学生のリクルート・販路拡大・技術提携などのよもやま話まで、「産・学」「産・産」がざっくばらんに話し合える場です。

「産・学」「産・産」連携による技術革新への絶好の機会として、是非ご参加ください。

## 【当日スケジュール】

13:00：開場・受付開始

13:30：開会

13:40：シーズ発表

5人の研究者によるシーズ発表  
企業による最新技術の紹介

※シーズ詳細は裏面参照

16:15：事務局からの連絡

16:20：ポスターセッション  
名刺交換会

17:00：終了

※発表者・プログラム等に変更になる場合がございます。

## ◆アクセス◆



◎JR埼京線  
「北与野」駅下車  
駅前ロータリー向い  
すく

◎JR京浜東北線  
・宇都宮線・高崎線  
「さいたま新都心」  
駅下車  
2階歩行者専用デッキ  
を北与野駅方面へ  
徒歩8分

※ご来場の際は、公共の交通機関をご利用ください。

◆【シース発表 13:40~16:15】◆

発表者	シース名・研究概要	連携企業先
埼玉県産業技術総合センター 技術支援室 機械技術担当 主任研究員 南部 洋平 氏 13:40~14:05	【低周波振動ドリルによる微細深穴加工】 当センターでは、燃料噴射ノズル等の金属材料に対して微細深穴をドリル加工する共同研究を行ってきた。本発表では、ドリルと材料の間に低周波振動を付加することでドリルの長寿命化を実現した事例を中心として、微細深穴加工に関する技術シースについて紹介する。	医療機器製造企業 自動車関連企業 製造業
東京電機大学 工学部 先端機械工学科 准教授 小林 宏史 氏 14:05~14:25	【光リソグラフィを利用したマイクロ部品製作】 本研究室では、光リソグラフィ技術を用いたマイクロオダの微細加工を簡便・安価にするための技術研究を行なっている。発表では、自作した露光実験装置や円筒部品への微細加工方法など、研究室での取り組みについて簡単に紹介する。	光学機器製造企業
芝浦工業大学 システム理工学部 機械制御システム学科 助教 酒井 康德 氏 14:25~14:50	【振動やレーザーの精密加工への応用】 本研究室では、レーザーや振動を複合した新たな加工原理の実現に向けて、様々な研究開発を推進している。本発表では、振動応用による“回転しないドリル”や、レーザーを攪拌接合加工に応用した事例を中心として、研究室で育んでいる技術シースについて紹介する。	医療機器製造企業 計測機器開発企業 建設機械製造業 製造業
埼玉工業大学 工学部 機械工学科 准教授 長谷 亜蘭 氏 15:00~15:25	【精密加工における技術と技能 ～加工モニタリング技術と技能五輪の紹介～】 本講演では、材料が変形・破壊する際に生じる弾性応力波を計測するアコースティックエミッション法（AE法）の概要とその精密加工モニタリングへの適用事例を紹介する。また、日本の精密加工技術を支えている職人技の例として、技能五輪全国大会 精密機器組立て職種の競技について紹介する。	工作機械製造企業 自動車製造企業 軸受製造企業 金属製品製造業 ガラス製品製造業 高分子材料製造業 潤滑油等製造業
日本工業大学 基幹工学部 機械工学科 教授 二ノ宮 進一 氏 15:25~15:50	【PCDを利用した精密加工とPCDの加工】 当研究室では、難加工材の高効率・高精度加工技術に関する研究や、環境調和型精密加工技術に関する研究に取り組んでいる。今回は、多結晶ダイヤモンド焼結体（PCD）を利用した精密加工およびPCD自体の高精度加工に関する技術シースについて紹介する。また、精密加工の加工特性向上を目指して、加工液からアプローチする技術についても述べる。	難切削材加工企業
(株)入曽精密 (株)微細切削加工研究所 代表取締役 斎藤 清和 氏 15:50~16:15	【段取り替え自動化ロボット“ORIGAMI”が拓く微細切削加工の未来】 (株)入曽精密が自社開発した、縦型切削加工機に後載せ可能な、段取り替え自動化ロボット“ORIGAMI”をご紹介します。微細切削加工の可能性、将来性について解説いたします。また、微細切削加工のために必要となる現場のためのノウハウについてもご紹介する。	切削加工企業

◆参加申込書◆

会社・団体名			
部署名			
役職名		氏名	
TEL	—	FAX	—
E-mail			
住所			

**SIPC**

お申込は  
FAXかメールで

FAX : 048-857-3921  
Mail : sangaku@saitama-j.or.jp

◆お問合せ先：産学連携支援センター埼玉〔(公財)埼玉県産業振興公社・(公財)さいたま市産業創造財団〕

※本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、本交流会の連絡及び主催者が実施するセミナー等の案内のみに利用させていただきます。